

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。由於這僅為概要，故並不包含可能對閣下具有重要性的所有資料。閣下決定是否投資[編纂]前應閱讀本文件全文。

任何投資均有風險，某些與投資[編纂]有關的特定風險載於本文件第36頁「風險因素」一節。閣下決定是否投資[編纂]前應仔細閱讀該節。

概覽

我們的業務模式

我們是全球領先的200mm純晶圓代工廠。根據IBS的資料，按二〇一三年銷售收入總額計算，我們是全球第二大200mm純晶圓代工廠，而且是世界第六大純晶圓代工廠，按銷售收入計算，我們於全球整體代工市場的市場份額為1.4%。更多詳情請參閱本文件第76頁「行業概覽—代工行業」。我們主要專注製造特種應用的200mm晶圓半導體。我們的製造專業知識來自多年來為200mm晶圓的製造研發先進及差異化的技術，尤其是嵌入式非易失性存儲器及功率器件。我們的組合亦包括RFCMOS、模擬及混合信號、CMOS圖像傳感器、電源管理及MEMS等多種其他先進工藝技術。於二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年以及截至二〇一三年及二〇一四年六月三十日止六個月，我們分別產生約3,080萬美元、3,020萬美元、3,030萬美元、1,460萬美元及1,770萬美元的研發開支，分別佔我們於該等期間銷售收入的5.1%、5.3%、5.2%、5.2%及5.5%。我們採用自身的專有工藝及技術，為多元化的客戶製造符合其設計規格的半導體，客戶包括(i)集成器件製造商；及(ii)系統及無廠半導體公司。我們亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製造成品率各方面均達致完善的複雜設計。

我們透過華虹NEC及上海宏力擁有悠久經營往績，該兩家公司分別於一九九九年及二〇〇三年開始經營，並於二〇一三年併入華虹宏力。

我們的行業

我們在國內外與純晶圓代工服務提供商以及集成器件製造商(將其一部分製造產能用於半導體代工業務)進行競爭。根據IBS的資料，二〇一三年按銷售收入計全球代工市場的規模為420億美元，較二〇〇八年的215億美元年複合增長率為14.3%。預計全球代工市場至二〇二〇年按銷售收入計達到693億美元，二〇一三年至二〇二〇年的年複合增長率為7.4%。業內半導體公司根據他們對眾多因素的評估而選擇採用150mm晶圓、200mm晶圓或300mm

概 要

晶圓來製造其產品，該等因素可能包括(其中包括)每種產品的設計幾何尺寸、設計複雜性、電能要求、光罩成本、代工服務成本、預期製造成品率及預期產量。儘管部分產品可採用200mm或300mm晶圓製造，但我們相信200mm晶圓的製造方案一般會更具成本效益，尤其是小量產品。

我們部分製造200mm晶圓的設備現時已不再生產且幾乎已完全折舊。因此，我們必須採購若干二手或工廠翻新設備以應付我們的擴充需求，此舉乃200mm晶圓代工行業內的一般慣例。隨著技術不斷演變，300mm晶圓的製造成本持續改善，特別是折舊開支及光罩成本下跌，採用200mm晶圓的製造成本優勢或會在短期內減小。儘管如此，因製造技術由150mm進展至200mm及至300mm晶圓，製造體積較小晶圓的半導體代工公司已能夠通過改善產品組合以專注於特定產品而保持競爭力。因此，IBS相信，200mm半導體代工公司仍能在不久的未來爭取市場機遇並維持盈利能力。我們相信，縱使我們預期較300mm半導體代工公司所具有的成本優勢預期逐漸削弱，我們作為專門的200mm半導體代工公司在可見未來將仍然能夠抓緊市場機遇，我們無法向閣下保證我們能在日後繼續有效競爭或日後利用差異化技術製造的產品的市場將會增長或繼續保持穩定。請參閱本文件第45頁「風險因素－有關我們行業的風險－我們的業務計劃乃假定對我們所專注的特種應用的200mm晶圓的代工服務的持續需求。倘這一需求並無按我們所預期的方式繼續發展，我們的業務可能無法成功」。

製造技術

我們在1.0 μ m至90nm技術節點上開發並向客戶提供先進的差異化晶圓加工技術組合。尤其是，我們是設計及製造需要嵌入式非易失性存儲器工藝技術的半導體方面的專家。我們相信，與我們的競爭對手相比，我們的嵌入式非易失性存儲器解決方案能夠在相對更小裸晶尺寸上發揮卓越性能，讓我們成為智能卡及微控制器等多種快速發展的嵌入式非易失性存儲器應用的首選半導體代工公司。我們在功率器件技術方面亦擁有強大的能力，且擁有一個專門製造功率器件產品的晶圓廠。透過靈活而可定製的製造平台，我們得以滿足各種客戶的特定需求。我們亦依賴許可技術(如Cypress提供的基於SONOS的嵌入式非易失性存儲器及SST提供的基於SuperFlash的嵌入式非易失性存儲器)以及第三方的專利許可。截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止年度及截至二〇一四年六月三十日止六個月，應用或引入我們獲第三方授權使用的技術的產品銷售額佔我們的銷售收入分別約39%、42%、46%及50%。我們無法向閣下保證我們將來能夠按我們認為合理的條款或甚至是否能取得任何或全部必要的許可。請參閱本文件第41頁「風險因素－有關我們業務的風險－倘我們不能取得、保持及保護知識產權，我們的競爭地位或會受到損害」。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

按技術平台劃分的銷售收入

下表列示我們於所示期間按技術平台劃分的銷售收入明細（以絕對金額及佔我們銷售收入總額的百分比列示）。

	截至十二月三十一日止年度						截至六月三十日止六個月			
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年		二〇一三年		二〇一四年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
							(未經審核)			
嵌入式非易失性										
存儲器 ⁽¹⁾	202,410	33.2	175,378	30.7	203,468	34.8	91,717	32.5	130,007	40.1
邏輯及射頻 ⁽²⁾	99,522	16.3	111,155	19.5	119,628	20.5	56,317	20.0	53,801	16.6
分立器件 ⁽³⁾	121,468	19.9	125,945	22.0	114,118	19.5	56,424	20.0	64,825	20.0
模擬及電源管理 ⁽⁴⁾ ..	54,597	9.0	56,930	10.0	72,360	12.4	35,367	12.5	41,832	12.9
獨立非易失性										
存儲器 ⁽⁵⁾	106,774	17.5	83,360	14.6	67,051	11.5	37,095	13.2	31,447	9.7
其他 ⁽⁶⁾	25,073	4.1	18,712	3.2	8,094	1.3	4,917	1.8	2,543	0.7
銷售收入總額	<u>609,844</u>	<u>100.0</u>	<u>571,480</u>	<u>100.0</u>	<u>584,719</u>	<u>100.0</u>	<u>281,837</u>	<u>100.0</u>	<u>324,455</u>	<u>100.0</u>

附註：

- (1). 嵌入式非易失性存儲器包括用於遙控器、家電、智能儀錶等的微控制器及智能卡（如SIM卡、社保卡、國民身份證、USB鑰匙及銀行芯片卡）。
- (2). 邏輯產品包括消費音響產品、記憶卡(SD)控制器；射頻產品包括用於無線鍵盤或滑鼠、電子收費(ETC)裝置等的藍芽裝置。
- (3). 分立器件產品包括MOSFET、SBJFET及IGBT硅晶片，適用於消費產品（家電）、電腦、工業產品（如焊接機）及汽車產品（如轉向控制器）等多類不同市場分部。
- (4). 模擬及電源管理產品包括移動產品的音頻放大器IC、電池管理IC、家電、電腦及電源適配器的交直流轉換器IC，以及LED照明燈泡的控制器IC。
- (5). 獨立非易失性存儲器產品包括NOR閃存存儲器及EEPROM，適用於消費產品（家電）、電腦、通訊產品（如流動電話）及汽車產品（如資訊娛樂系統）等多類不同市場分部。
- (6). 包括高壓產品。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

下表列示我們於所示期間按技術平台劃分的銷售量明細(以絕對數量及佔我們總銷售量的百分比列示)。

	截至十二月三十一日止年度						截至六月三十日止六個月			
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年		二〇一三年		二〇一四年	
	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%
嵌入式非易失性										
存儲器	267.2	22.2	232.3	19.9	268.1	21.9	121.7	20.4	168.6	24.5
邏輯及射頻	158.6	13.2	190.4	16.3	204.4	16.7	98.4	16.5	98.1	14.3
分立器件	467.0	38.8	469.6	40.1	455.4	37.2	224.9	37.7	266.0	38.7
模擬及電源管理	121.0	10.1	126.3	10.8	183.9	15.0	89.4	15.0	103.9	15.1
獨立非易失性										
存儲器	141.9	11.8	117.2	10.0	97.7	8.0	54.4	9.1	46.0	6.7
其他	46.7	3.9	34.4	2.9	13.2	1.2	8.0	1.3	4.1	0.7
總銷售量	1,202.4	100.0	1,170.2	100.0	1,222.7	100.0	596.8	100.0	686.7	100.0

按工藝技術節點劃分的銷售收入

我們提供各種不同技術節點的可定製工藝組合。下表列示我們於所示期間按工藝技術節點劃分的銷售收入明細(以絕對金額及佔我們銷售收入總額的百分比列示)。

	截至十二月三十一日止年度						截至六月三十日止六個月			
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年		二〇一三年		二〇一四年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
0.13μm及以下 ⁽¹⁾	136,465	22.4	158,464	27.7	183,936	31.5	76,713	27.2	123,551	38.1
0.15μm及0.18μm	149,448	24.5	134,657	23.6	150,942	25.8	76,810	27.3	71,917	22.2
0.25μm	56,734	9.3	20,268	3.5	14,073	2.4	10,109	3.6	2,280	0.7
0.35μm及以上	267,197	43.8	258,091	45.2	235,768	40.3	118,205	41.9	126,707	39.0
銷售收入總額	609,844	100.0	571,480	100.0	584,719	100.0	281,837	100.0	324,455	100.0

附註：

(1) 包括0.13μm及0.11μm。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

下表為我們於所示期間按工藝技術節點劃分的銷售量明細（以絕對數量及佔我們總銷售量的百分比列示）。

	截至十二月三十一日止年度						截至六月三十日止六個月			
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年		二〇一三年		二〇一四年	
	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%
0.13 μm 及以下 ⁽¹⁾	185.1	15.4	208.9	17.9	248.4	20.3	104.9	17.6	164.9	24.0
0.15 μm 及0.18 μm	220.0	18.3	217.3	18.6	240.6	19.7	123.2	20.6	119.4	17.4
0.25 μm	71.3	5.9	28.8	2.5	20.9	1.7	15.0	2.5	4.1	0.6
0.35 μm 及以上	726.0	60.4	715.2	61.0	712.8	58.3	353.7	59.3	398.3	58.0
總銷售量	1,202.4	100.0	1,170.2	100.0	1,222.7	100.0	596.8	100.0	686.7	100.0

附註：

(1) 包括0.13 μm 及0.11 μm 。

製造設施

通過我們位於上海的三家晶圓廠，我們目前的200mm晶圓加工能力在中國名列前茅，截至二〇一四年六月三十日的200mm晶圓加工總產能約為每月124,000片。

下表列示各晶圓廠在歷史記錄期內的估算月產能、實際平均月產量及產能利用率。

	截至十二月三十一日			截至六月三十日
	二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年	二〇一四年
	(以每月千片200mm晶圓計，百分比除外)			
估計月產能				
一廠	50	50	50	50
二廠	32	34	34	34
三廠	37	38	40	40
總估計月產能	119	122	124	124
截至該日止期間				
平均月產量 (實際)	99	99	104	114
產能利用率 ⁽¹⁾	83%	81%	84%	92%

附註：

(1) 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

概 要

考慮發展策略及盈利增長，我們擬於二〇一六年年底前將200mm晶圓加工產能增至每月約164,000片晶圓，以應對客戶不斷增長的需求。

我們的客戶

我們服務多元化的客戶群，其中包括部分世界領先的半導體公司，如Cypress、Microchip及ON Semiconductor，為我們分別於截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止年度各年及截至二〇一四年六月三十日止六個月的十五大客戶。我們的客戶主要分為兩大類：(i)集成器件製造商及(ii)系統及無廠公司。根據IBS的資料，於歷史記錄期內，我們為全球20個國家逾600名客戶提供服務，包括前30家半導體公司(按二〇一三年估計銷售收入計)中的11家。

下表載列我們於所示期間按地域劃分的銷售收入明細(以絕對金額及佔我們銷售收入總額的百分比列示)。

	截至十二月三十一日止年度						截至六月三十日止六個月			
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年		二〇一三年 (未經審核)		二〇一四年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
中國 ⁽¹⁾	295,381	48.4	277,157	48.5	291,414	49.8	137,668	48.8	176,986	54.5
美國	218,747	35.9	178,576	31.2	146,458	25.0	77,205	27.4	66,412	20.5
日本 ⁽²⁾	39,239	6.4	32,305	5.7	53,154	9.1	22,223	7.9	20,020	6.2
亞洲 ⁽³⁾	46,657	7.7	62,028	10.9	51,500	8.9	29,288	10.4	32,471	10.0
歐洲	9,820	1.6	21,414	3.7	42,193	7.2	15,453	5.5	28,566	8.8
銷售收入總額	<u>609,844</u>	<u>100.0</u>	<u>571,480</u>	<u>100.0</u>	<u>584,719</u>	<u>100.0</u>	<u>281,837</u>	<u>100.0</u>	<u>324,455</u>	<u>100.0</u>

附註：

- (1) 包括香港。
- (2) 包括於歷史記錄期由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。
- (3) 不包括中國及日本。

於歷史記錄期內，中國為我們的最大市場。我們二〇一三年的銷售收入約50%來自立足於中國的半導體公司，例如華大、國民技術及同方微電子。我們擬繼續與我們的全球客戶緊密合作以及利用我們的規模及技術領先地位進一步應對快速發展的中國半導體行業所湧現的機遇。

概 要

我們的供應商

我們幾乎所有設備都在美國、日本、歐洲、韓國及台灣採購。截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日以及二〇一四年六月三十日，我們分別有51名、50名、49名及49名設備供應商。我們大部分的主要設備供應商已與我們合作超過九年。我們與設備製造商緊密合作，為若干先進技術採購切合我們所需的設備。於歷史記錄期內，我們並無經歷過任何對我們的業務構成重大影響的設備短缺或設備的質量問題。

我們為大部分原材料保持多個來源，即使任何一名賣方出現質量或交貨問題亦不會對我們的營運構成重大不利影響。截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日以及二〇一四年六月三十日，我們分別有109名、109名、80名及82名原材料供應商。我們大部分的主要原材料供應商已與我們合作超過九年。我們並無經歷過任何原材料短缺以致我們的營運受到重大影響，而且我們目前使用的原材料亦供應充足。

產品及應用

我們生產的半導體可被植入不同市場(包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車)的各種產品中。下表為所示期間我們按終端市場分部列示的銷售收入明細。

	截至十二月三十一日止年度						截至六月三十日止六個月			
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年		二〇一三年		二〇一四年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
							(未經審核)			
終端市場分部										
電子消費品	226,965	37.2	235,189	41.2	265,887	45.5	126,953	45.0	162,182	50.0
通訊	174,055	28.5	177,008	31.0	173,970	29.8	78,885	28.0	91,377	28.2
計算機	143,618	23.5	111,879	19.6	87,093	14.9	47,035	16.7	29,237	9.0
工業及汽車	65,206	10.8	47,404	8.2	57,769	9.8	28,964	10.3	41,659	12.8
銷售收入總額	609,844	100.0	571,480	100.0	584,719	100.0	281,837	100.0	324,455	100.0

政府補助

我們於歷史記錄期獲取大額政府補助。截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止年度以及截至二〇一四年六月三十日止六個月，我們獲得政府補助分別為6,940萬美元、4,840萬美元、2,890萬美元及80萬美元。於同期，4,610萬美元、4,070萬美元、1,530萬美元、780萬美元及1,210萬美元的政府補助獲撥至損益表，分別佔我們於該等期間的除稅後綜合溢利的48.2%、68.2%、24.6%、25.7%及27.1%。更多詳情，請參閱本文件第196頁「財務資料－影響我們的業務、財務狀況及經營業績的因素－政府補助」一節。

概 要

我們的競爭優勢

我們的競爭優勢包括：

- 專注於先進、差異化技術的領先200mm純晶圓代工廠；
- 關係持久的多樣化全球客戶群；
- 規模龐大且快速成長的中國半導體市場中的成熟企業；
- 靈活而可定製的製造平台；
- 具競爭力的成本架構以及注重股東價值；及
- 由資深高級管理層領導的優秀員工。

我們的業務策略

為發展業務及為股東創造價值，我們擬實施以下主要策略：

- 繼續改善產品組合，把握高利潤率及高增長率的機會；
- 繼續研發我們的主要競爭優勢之一的差異化先進技術；
- 繼續實現合併協同效益；
- 追求策略及盈利上的產能擴充；及
- 強化與主要客戶的合作並繼續提供優質服務。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

綜合財務資料概要

下文為我們於所示期間及截至所示期間止的綜合財務資料概要，摘自本文件附錄一所載會計師報告。

綜合損益表

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年	二〇一三年	二〇一四年
	千美元	千美元	千美元	千美元 (未經審核)	千美元
銷售收入	609,844	571,480	584,719	281,837	324,455
銷售成本 ⁽¹⁾	(459,172)	(453,559)	(459,270)	(215,870)	(231,937)
毛利	150,672	117,921	125,449	65,967	92,518
其他收入及收益 ⁽²⁾	50,998	26,492	30,605	14,026	10,446
投資物業公平值收益	1,322	944	2,095	1,585	412
銷售及分銷費用	(10,290)	(8,831)	(8,052)	(3,868)	(3,373)
管理費用 ⁽¹⁾	(61,327)	(55,097)	(69,043)	(35,089)	(38,358)
其他費用	(5,618)	(448)	(199)	(190)	(1,827)
財務費用	(19,168)	(16,928)	(16,479)	(8,159)	(6,539)
分佔一家聯營公司溢利	—	3,619	6,437	—	4,503
稅前溢利	106,589	67,672	70,813	34,272	57,782
所得稅開支	(10,966)	(7,993)	(8,964)	(3,884)	(13,085)
年／期內溢利	95,623	59,679	61,849	30,388	44,697

附註：

- 銷售成本及管理費用包括確認為相應銷售成本及管理費用的抵銷項目的政府補助。截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止年度及截至二〇一三年及二〇一四年六月三十日止六個月，我們分別確認2,320萬美元、2,030萬美元、1,070萬美元、540萬美元及830萬美元政府補助為銷售成本的抵銷項目，及我們分別確認2,290萬美元、2,040萬美元、460萬美元、240萬美元及380萬美元政府補助為管理費用內研發開支的抵銷項目。
- 截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止年度及截至二〇一三年及二〇一四年六月三十日止六個月，分別包括政府補貼790萬美元、120萬美元、55萬美元、6萬美元及零。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

綜合財務狀況表摘要

	截至十二月三十一日			截至 六月三十日
	二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年	二〇一四年
	千美元	千美元	千美元	千美元
流動資產總值	614,530	526,434	603,786	582,066
流動負債總額	392,464	314,283	323,859	323,859
流動資產淨值	222,066	212,151	279,927	258,207
非流動資產總值	1,057,632	1,081,540	1,043,831	1,084,920
非流動負債總額	377,425	329,934	267,539	251,779
淨資產	902,273	963,757	1,056,219	1,091,348

綜合現金流量表摘要

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年	二〇一三年	二〇一四年
	千美元	千美元	千美元	千美元 (未經審核)	千美元
經營活動產生的現金淨額	232,379	168,932	184,234	74,233	67,884
投資活動所用現金淨額	(97,623)	(149,560)	(16,754)	(27,088)	(59,061)
融資活動(所用)／ 所得現金淨額	(106,730)	(130,644)	(72,059)	17,330	(26,131)
現金及現金等價物 增加／(減少)淨額	28,026	(111,272)	95,421	64,475	(17,308)
年／期初現金及現金等價物	309,851	329,738	218,170	218,170	317,045
匯率變動影響淨額	(8,139)	(296)	3,454	2,633	(1,601)
年／期末現金及現金等價物	329,738	218,170	317,045	285,278	298,136

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

主要財務比率

下表載列於所示日期及截至所示日期止期間的主要財務比率：

財務比率	公式	截至十二月三十一日／ 截至十二月三十一日止年度			截至 二〇一四年 六月三十日／ 截至 二〇一四年 六月三十日 止六個月
		二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年	
盈利能力比率：					
1. 增長					
a. 銷售收入增長...	a. 同比增長	—	(6.3)%	2.3%	15.2%
b. 純利增長	b. 同比增長	—	(37.6)%	3.6%	47.1%
2. 利潤率					
a. 毛利率	a. 毛利／銷售 收入 × 100.0%	24.7%	20.6%	21.5%	28.5%
b. 純利率	b. 期內溢利／銷售 收入 × 100.0%	15.7%	10.4%	10.6%	13.8%
3. 權益回報率					
a. 權益回報率	a. 期內溢利／平均 總權益 × 100.0%	11.7%	6.4%	6.1%	4.2%
b. 總資產報酬率...	b. 期內溢利／平均 總資產 × 100.0%	5.8%	3.6%	3.8%	2.7%
流動資金比率：					
1. 流動資金比率					
a. 流動比率	a. 流動資產／流動負債	1.6	1.7	1.9	1.8
b. 速動比率	b. (流動資產－存貨)／ 流動負債	1.3	1.4	1.6	1.5
2. 周轉比率					
a. 存貨周轉天數...	a. 平均存貨／銷售 成本 × 365天或183天	82	82	78	71
b. 應收款項周轉... 天數(平均 收款期)	b. 平均貿易應收款項／ 銷售收入 × 365天 或183天	62	63	66	65
c. 應付款項周轉... 天數(平均 付款期)	c. 平均貿易應付款項／ 銷售成本 × 365天 或183天	48	45	47	48
資本充足率：					
1. 資本負債比率	(銀行借款及其他借款 總額－現金及現金等價 物以及已抵押存款及 定期存款)／總權益 × 100.0%	18.3%	20.6%	4.5%	3.0%
2. 利息償付比率	息稅前溢利／財務費用	6.6	5.0	5.3	9.8

有關我們主要財務比率的進一步詳情，請參閱本文件第247頁「財務資料－主要財務比率」一節。

概 要

我們的股權架構

控股股東

緊隨[編纂]完成後，並無計及因超額配股權獲行使而可能發行的股份，華虹集團及上海聯和將於本公司已發行股本中分別擁有約[編纂]及[編纂]的權益。此外，上海聯和控制華虹集團51.83%的投票權，乃由於其擁有華虹集團的47.08%股權及額外4.75%投票權乃根據儀電控股與上海聯和的投票集團取得。緊隨[編纂]完成後，華虹集團、上海聯和及儀電控股將分別被視為本公司的控股股東。

近期發展

自二〇一四年六月三十日以來，我們的銷售收入、毛利及成本結構保持穩定，而我們的業務增長步伐與過往趨勢及預期一致。董事確認，自二〇一四年六月三十日起直至本文件日期，我們的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動，且自二〇一四年六月三十日起直至本文件日期並無會對附錄一會計師報告所示資料造成重大影響的事件。

[編纂]統計數字⁽¹⁾

- [編纂]規模： 初步為本公司經擴大已發行股本的[編纂]
- [編纂]架構： 初步為[編纂]作[編纂] (可予調整) 及[編纂]作[編纂] (可予調整及視超額配股權行使與否而定)
- 超額配股權： 佔根據[編纂]初步提呈的[編纂]數目最多15%
- 每股[編纂]： 每股[編纂][編纂]至[編纂]

	基於每股[編纂] [編纂]的[編纂]	基於每股[編纂] [編纂]的[編纂]
[編纂]完成後本公司的市值 ⁽²⁾	[編纂]	[編纂]
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 ⁽³⁾	[編纂]	[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

附註：

- (1) 本表所有統計數據均假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 市值根據緊隨[編纂]完成後預期將發行[編纂]股股份來計算。
- (3) 未經審核備考經調整每股有形資產淨值乃於作出本文件附錄二「未經審核備考財務資料」所述的調整後，基於緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股股份按每股股份[編纂]及[編纂]的[編纂]計算。

未來計劃及所得款項用途

下表載列我們將收取的[編纂]估計所得款項淨額（經扣除承銷費用及佣金（假設悉數支付酌情獎勵費）以及我們就全球發售應付的預計費用）：

	假設超額配 股權未獲行使 (以美元計)	超額配股權 獲悉數行使 (以美元計)
假設[編纂]為每股[編纂][編纂] (即本文件所述[編纂]範圍的中位數)	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股[編纂][編纂] (即本文件所述[編纂]範圍的上限)	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股[編纂][編纂] (即本文件所述[編纂]範圍的下限)	[編纂]	[編纂]

假設[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]（即本文件所述[編纂]範圍的中位數）以及超額配股權未獲行使，我們擬將[編纂]所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 所得款項淨額約[編纂]（或[編纂]）將用於擴充我們的產能，具體為於設備、工具及設施的投資。有關詳情，請參閱「業務－製造設施及技術－產能及利用率－技術升級及產能擴充計劃」。
- (ii) 所得款項淨額約[編纂]（或[編纂]）將用於研發、技術及知識產權投資。

概 要

(iii) 所得款項淨額餘下約[編纂] (或[編纂]) 的金額將用於為我們的營運資金提供融資及其他一般公司用途。

若[編纂]定在較估計[編纂]範圍的中位數為高或為低的水平，上述所得款項分配將按比例予以調整。

進一步詳情請參閱本文件第255頁「未來計劃及所得款項用途」一節。請亦參閱本文件第115頁「業務－我們的業務策略」。

股息政策

於歷史記錄期我們並無宣派任何股息，目前我們亦無意派付二〇一四年股息。[編纂]完成後，我們可能以現金或我們認為合適的其他方式分派股息。請參閱本文件第251頁「財務資料－股息政策」一節。

風險因素

我們的營運及[編纂]涉及若干風險，其中許多不在我們控制範圍內。該等風險可分類為：(i)有關我們業務的風險，(ii)有關我們行業的風險，(iii)與在中國經營業務有關的風險，及(iv)與[編纂]及我們的股份有關的風險。我們認為，我們面臨的最重大的風險包括：

- 倘我們無法在我們專注的特種應用方面保持技術領導者地位，或倘我們無法及時應對快速變化的半導體市場動態，我們的競爭力或會下降；
- 倘我們無法有效地管理產能及優化生產設施，我們的競爭力可能被削弱；及
- 倘我們不能持續保持高產能利用率、優化晶圓生產的產品組合及保持製成品率，我們的利潤率或會大幅下滑。

有關所涉及的所有風險因素的詳細討論，載於本文件第36頁「風險因素」一節。閣下在決定投資[編纂]前應仔細閱讀整個章節。

概 要

已產生及將產生的上市開支

截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止三個年度，我們並無產生任何上市費用。截至二〇一四年六月三十日止六個月，我們產生上市開支約[編纂]。截至二〇一四年十二月三十一日止年度，我們預期將產生上市費用(不包括承銷佣金)合計約[編纂]，其中[編纂]預期將確認為管理費用，及[編纂]預期將直接確認為權益減值。董事預期，該等開支不會對我們截至二〇一四年十二月三十一日止年度的財務業績產生重大不利影響。承銷佣金(假設悉數支付酌情獎勵費)按本文件所列[編纂]範圍的中位數計算及在假設超額配股權並無獲行使的情況下為[編纂]，而該金額將會全數透過抵銷所得款項總額自本公司的股權中扣除。